키움증권

NEW ETF Line-up

반도체 소부장, 美 피지컬AI, CPU 반도체, 글로벌 MLCC·기판 등 ETF 7종 상장

10월 3주차

키움증권 리서치센터 글로벌리서치팀
ETF Analyst 김진영 I RA 조호준



New ETF 개요

상장 개요

'26.10.20(화) 국내 증시에 **ETF 7종목** 신규 상장 예정

*상장일(2026. 10. 20) 기준 ETF 상장종목수: 총 1,183종목

상품 요약

▲ **RISE 반도체소부장액티브** (0254H0)
- **반도체 소재·부품·장비 관련 키워드 유사도가 높은 국내** 기업 중 **시가총액 상위 기업**에 투자하는 **액티브 ETF**

▲ **KODEX 27-12 금융채(AA-이상) 액티브** (0254C0)
- **'27년 11월부터 12월** 사이 만기가 도래하는 **신용등급 AA-이상**의 **은행채**(특수은행채 포함), **카드채 등**에 투자하는 **액티브 ETF**

▲ **KODEX 미국배당다우존스액티브** (0254S0)
- 미국의 **대표 배당성장지수**(Dow Jones U.S. Dividend 100)를 **비교지수로 하는 액티브 ETF**

▲ **마이티 미국피지컬AI액티브** (0236J0)
- 미국의 **피지컬 AI 기업**에 투자하는 **액티브 ETF**

▲ **ACE 미국CPU반도체TOP3+** (0252V0)
- **미국** 상장 **CPU 반도체** 및 **CPU 반도체 부품**을 **설계·생산**하는 **10종목**을 편입하는 **패시브 ETF**

▲ **TIGER 글로벌MLCC&기판** (0255E0)
- **한국, 일본, 대만** 상장기업 중 **종합 전자부품기업, 전자소재 제조기업, PCB업체** 등의 산업 분류에 속하는 기업에 투자하는 **패시브 ETF**

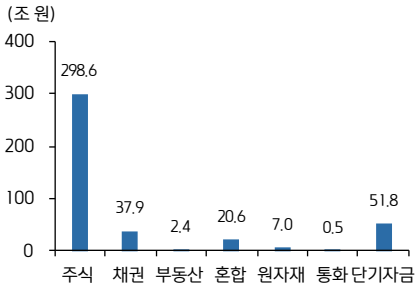
▲ **1Q 엔비디아고정미국AI반도체** (0256C0)
- **엔비디아**를 비롯한 **미국 AI 반도체 산업 핵심기업 10종목**에 투자하는 **패시브 ETF**

ETF 시장 Snapshot

구분	'26.10.09~10.16	'26.10.02~10.09
상장 종목 수	1176 개 (▲4 개)	1172 개
순자산 총액	422.5 조 원 (▼36 조)	458.5 조 원
총 거래량	608.6 억 주 (▲391.7 억)	216.9 억 주
총 거래대금	120.7 조 원 (▲66.5 조)	54.2 조 원

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.10.16 기준

국내 ETF 유형별 순자산



자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.10.16 기준

신규 출시 ETF 개요(1)

구분	RISE 반도체소부장액티브	KODEX 27-12 금융채(AA-이상)액티브	KODEX 미국배당다우존스액티브	마이티 미국피지컬 AI 액티브
코드	0254H0	0254C0	0254S0	0236J0
상품 유형	주식형	채권형	주식형	주식형
운용사	KB 자산운용	삼성자산운용	삼성자산운용	DB 자산운용
기초(비교) 지수	KEDI 반도체소부장지수	KAP 27-12 금융채 총수익지수(AA-이상)	DowJones U.S. Dividend 100 Index	iSelect 미국 피지컬 AI 지수
복제방법	실물 (액티브)	실물 (액티브)	실물 (액티브)	실물 (액티브)
총보수 (운용보수)	0.63% (0.589%)	0.09% (0.076%)	0.45% (0.419%)	0.86% (0.800%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 / 퇴직연금 100%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	30종목	66종목	99종목	25종목
정기 변경	3, 6, 9, 12월 마지막 영업일	(신용등급 하락, 발행기업 부도, 편입채권 10종목 이하)	정기변경: 3월 비중조절: 3, 6, 9, 12월	1, 4, 7, 10월

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

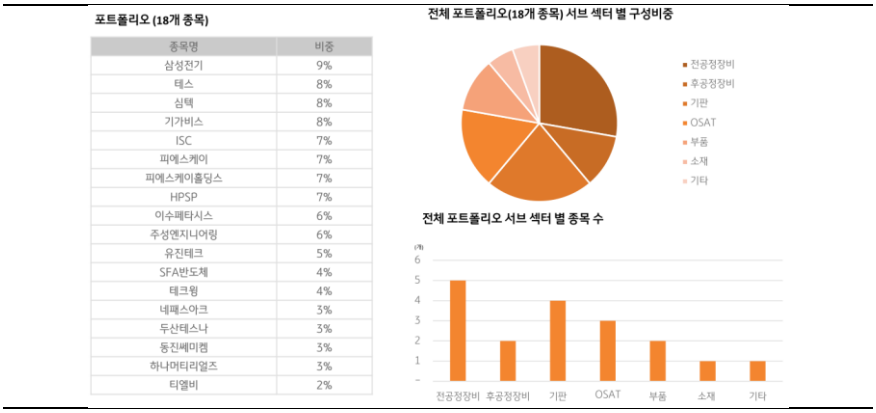
신규 출시 ETF 개요(2)

구분	ACE 미국 CPU 반도체 TOP3+	TIGER 글로벌 MLCC&기판	1Q 엔비디아고정미국 AI 반도체
코드	0252V0	0255E0	0256C0
상품 유형	주식형	주식형	주식형
운용사	한국투자신탁운용	미래에셋자산운용	하나자산운용
기초(비교) 지수	FnGuide 미국 CPU 반도체 TOP3+ 지수	Solactive-KEDI Global MLCC and Semiconductor Substrate Index	iSelect 엔비디아고정미국 AI 반도체
복제방법	실물 (패시브)	실물 (패시브)	실물 (패시브)
총보수 (운용보수)	0.49% (0.449%)	0.49% (0.439%)	0.49% (0.449%)
연금투자 가능 여부	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%	개인연금 100% / 퇴직연금 70%
구성종목 수	10종목	13종목	10종목
정기 변경	1, 4, 7, 10월 세 번째 금요일 익영업일	3, 6, 9, 12월 두 번째 금요일	매월 옵션만기일 익주 첫 영업일

자료: KRX, 각사, 키움증권 리서치

신규 출시 ETF 한 눈에 보기

ETF 명 (코드)	RISE 반도체소부장액티브 (0254H0)
개요	- 반도체 소재·부품·장비 관련 키워드 유사도가 높은 국내 기업 중 시가총액 상위 기업에 투자하는 액티브 ETF
특징	- 메모리 업황 강세의 낙수효과가 반도체 소재·부품·장비사로 번지는 흐름 속 서브 섹터간 Top-Down 전략, 섹터 내 Bottom-Up 전략을 구사함과 동시에 수주 모멘텀 등 이벤트도 반영한 Active한 운용 전략 활용
비교지수	- KEDI 반도체소부장 지수
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 유가증권시장 및 코스닥 상장 보통주 中 - 시가총액 1,000억원 이상, 3개월 일평균 거래대금 3억원 이상 - 업종요건: KICS Primary Level 3 기준 기초 화학 물질 제조업, 산업종 기계 제조업, 반도체 및 기타 전자부품 제조업, 항해용·측정용·전자의료용 및 제어 장비 제조업인 종목 ▶ 선정기준: KEDI의 LLM 유사도 평가 모델 활용 LLM 점수 0.5점 이하인 종목 제외 후 시가총액 상위 30개 종목 - 키워드: 반도체 소재, 반도체 부품, 반도체 장비 핵심 세부 키워드: 반도체 공정 투입 소재, 반도체 소자·패키지·테스트 부품, 반도체 제조 및 검사·테스트 장비 ▶ 비중결정방식: 최종 편입 종목 비중점수*에 비례하여 개별 종목 편입비중 배분 *비중점수 = (LLM 유사도 점수 x 50%) + (시가총액 정규화 수치 x 50%)
출시 배경 및 투자포인트	▶ **반도체 슈퍼사이클 2막, 낙수효과 기대되는 반도체 소부장:** AI 인프라 투자 확대와 HBM 생산능력 우선 배분으로 서버 DRAM 공급 부족이 2027년까지 지속될 전망. TrendForce는 4Q26 범용 DRAM 계약가격이 QoQ 10~15% 상승할 것으로 예상. 주요 클라우드 기업들의 다년간 장기공급계약(LTA) 체결도 확대되며 메모리 업체의 출하 물량 및 실적 가시성이 높아지는 구조. AI 서버뿐 아니라 일반 서버용 DRAM 수요도 증가하면서 반도체 장비·기판·패키징 등으로 투자 수혜 확산 기대 ▶ **메모리 초과이익이 소부장으로 넘어가는 구간:** 메모리 가격 상승에 따른 제조사의 수익성 개선이 설비투자 확대와 소부장 기업의 수주 증가로 연결되는 국면. 장비업체는 신규 생산라인 투자와 공정 전환에 따른 수주 확대, 소재·부품업체는 웨이퍼 투입량 증가와 공정 고도화에 따른 공급 물량 확대가 핵심 성장 동력. 특히 AI 메모리 고도화로 첨단 패키징·테스트·기판 등 고부가 공정의 중요성이 높아지는 가운데, 메모리 제조사의 투자 확대가 소부장 기업의 매출 성장과 수익성 개선으로 이어질 가능성에 주목 ▶ **섹터 전문가 협업으로 18종목 압축 운용:** 서브섹터 간 주가 상승 강도 차이를 Top-Down으로 반영하고, 같은 섹터 안에서 Top pick 위주로 종목을 압축하는 구조. 9/23 기준 예시 포트폴리오는 삼성전기(9%), 테스·심텍·기가비스(각 8%), ISC·피에스케이·피에스케이홀딩스·HPSP(각 7%) 등 18종목으로 구성. 비교지수 대비 전공정 장비와 기판을 높게, 소재는 낮게 가져가는 전략
참고자료	**'RISE 반도체소부장액티브 ETF'** 포트폴리오 예시



자료: KB자산운용 주)2026년 9월 23일 기준. 운용 시점에 따라 변동 가능

ETF 명 (코드)	KODEX 미국배당다우존스액티브 (0254S0)
개요	- 미국의 대표적 배당성장지수(Dow Jones U.S. Dividend 100)를 비교지수로 하는 액티브 ETF
특징	- 미국배당다우존스 지수의 배당 성장주 틀은 유지하면서, 연 1회 정기변경의 한계를 액티브 스크리닝으로 보완해 초과성과를 추구
비교지수	- Dow Jones U.S. Dividend 100 Index
종목 선정 기준	▶ 유니버스: Dow Jones U.S. Broad Stock Marktet Index 구성종목 中 (리츠 제외) - 10년간 연속 배당금 지급, 유동시가총액 500 Mil USD 이상, 3개월 일평균 거래대금 2 Mil USD 이상 + 연배당수익률 상위 50% ▶ 선정기준: 네 가지 항목*별 순위 가중평균 스코어링해 종합 순위 상위 100개 종목 편입 * 항목: 1) 총부채 대비 잉여현금흐름(Free Cash Flow to Total Debt, 2) 자기자본이익률(ROE), 3) 연배당수익률(AD yield), 4) 5년배당성장률(Five year dividend growth) - 종목 구성이 100개 미만일 경우, 다음 순위의 종목 편입. 동일한 점수인 종목이 2개 이상이라면 더 높은 배당률을 가진 종목 ▶ 비중결정방식: 유동시가총액 가중방식
출시 배경 및 투자포인트	▶ **연 1회 정기변경의 한계, 액티브로 보완:** 비교지수(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)는 매년 3월 종목을 교체하고 이후 분기에는 비중만 조정하는 구조. 다만 시장 주도 업종이 빠르게 바뀌는 환경에서는 기존 배당주 중심의 고정된 포트폴리오로는 성장 기회를 놓칠 수 있음. 가령 최근 10개 분기 동안 S&P500 상위 섹터가 8차례 바뀌는 사이 미국배당다우존스는 2차례(금융→에너지→필수소비재)만 교체, 정기변경 직후 분기에 IT 섹터가 +23.7%(25년 2분기), +31.8%(26년 2분기) 오를 때 지수 비중 상위였던 에너지는 -8.6%, -13.4%를 기록. 이에 기본적인 배당성장 투자 원칙은 유지하되, 기업 실적과 업종별 성장 전망을 반영해 종목·비중을 수시로 조정함으로써 시장 변화에 유연하게 대응하고 초과수익 추구 ▶ **액티브 스크리닝으로 기회를 넓히며 리스크는 줄임:** 기존 지수는 10년 연속 배당 지급 이력과 현금흐름·ROE·배당성장률·배당수익률 등을 기준으로 우량 배당주 약 100개를 선정. 동 ETF는 여기에 액티브 스크리닝을 더해 배당 이력이 10년 미만이더라도 성장성이 우수한 기업이나 기존 지수에서 제외된 리츠까지 편입 검토. 주가 상승으로 배당수익률이 낮아진 우량 성장주는 선별적으로 유지하는 반면, 실적 악화나 주가 급락으로 배당수익률만 높아진 '배당 함정' 기업은 비중을 축소하는 등 성장성과 배당 지속가능성을 함께 평가 ▶ **변동성 장세에서 배당과 성장을 동시 추구:** 금리·환율·글로벌 이슈로 변동성이 큰 장세일수록 꾸준히 성장하면서 정기적으로 분배금을 줄 수 있는 기업이 중요. 월분배형 ETF를 운용해 온 KODEX가 출시한 미국배당다우존스 업그레이드 버전으로, 정량 기준과 액티브 판단을 결합해 시장 변화에 더 민감하게 대응
참고자료	'KODEX 미국배당다우존스액티브 ETF'의 강화된 종목 선별 절차



자료: S&P, Bloomberg, 삼성자산운용
주) 상기 내용은 향후 달라질 수 있음

ETF 명 (코드)	ACE 미국CPU반도체TOP3+ (0252V0)
개요	- 미국에 상장된 CPU 반도체 및 관련 부품을 설계·생산하는 10종목으로 구성된 패시브 ETF
특징	- 에이전트 AI 시대에 다시 주목받는 CPU에 투자하는 ETF로, ARM·AMD·인텔 3사에 각 25% 상한으로 집중 투자하며 나머지 7종목으로 CPU 밸류체인에도 투자
기초지수	- FnGuide 미국 CPU 반도체 TOP3+ 지수
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 미국 거래소(NASDAQ, NYSE) 상장 보통주 中 - 시가총액 USD 500 Million 이상, 최근 6개월 일간 거래대금 평균 USD 10 Milion 이상 (약 150억원) ▶ 선정기준: 카테고리별 스코어링 분석 - Tier1: AI 에이전트 특화 CPU 설계 관련 기업 선정 - Tier2: AI 에이전트 특화 CPU 생산(조립) 및 관련 부속품, 메모리, 네트워킹 반도체 관련 기업 - Tier1 스코어 상위 3종목 선정 + Tier1 키워드 점수x시가총액 8:2 가중하여 2개 종목 선정 -> Tier2 키워드 점수x시가총액을 8:2로 가중하여 상위 5개 기업 선정 ▶ 비중결정방식: 카테고리별 키워드 스코어, 시가총액 혼합 가중방식 - Tier1 키워드 스코어 상위 3종목(각 25%, Cap 25%), 나머지 7종목 중 상위 2개 종목(Tier1 스코어 8 x 시가총액 2, Cap 7%), 나머지 5종목(Tier2 스코어 8 x 시가총액 2, Cap 7%)
출시 배경 및 투자포인트	▶ **에이전트 AI 확산, CPU 수요의 구조적 전환:** 기존 챗봇과 달리 에이전트 AI는 계획 수립→도구 실행→결과 검증을 반복하면서 CPU가 전체 작업을 조율하는 '오케스트레이터'로 부상. GPU 중심의 AI 학습 인프라에서 1:4~1:8 수준이던 CPU 비율이 에이전트 AI 환경에서는 1:1~1:2까지 높아질 전망. BofA는 글로벌 서버 CPU 시장이 2025년 350억 달러에서 2030년 2,106억 달러로 약 6배 성장할 것으로 예상. 서버 CPU 조달 기간도 기존 16~20주에서 25~30주로 길어지는 등 AI 인프라의 새로운 공급 병목으로 부각 ▶ **인텔 독주에서 3강 경쟁, 함께 커지는 파이:** 서버 CPU 시장은 인텔이 주도하던 x86 중심 구조에서 AMD의 고성능 EPYC, ARM 기반 저전력·맞춤형 CPU 등으로 경쟁 구도가 다변화되는 중. 인텔은 기존 서버 생태계와 폭넓은 고객 기반, AMD는 고성능·고효율 제품 경쟁력, ARM은 전력효율과 클라우드 사업자의 자체 칩 설계 수요를 기반으로 성장 기회 확보. 특히 에이전트 실행을 위한 CPU 수요가 기존 GPU 인프라에 추가되면서 시장 자체가 확대되는 구조로, 점유율 경쟁 속에서도 주요 CPU 기업들이 동반 성장할 수 있는 포지티브섬 국면에 주목 ▶ **ARM·AMD·인텔 Top3 + AI 밸류체인 7종:** ARM·AMD·인텔에 각각 25%씩, 합산 75%를 배분해 CPU 시장의 주요 성장 기업에 집중 투자. 나머지 25%는 엔비디아·TSMC·퀄컴·HPE·마이크론·델·마벨 등 7개 기업을 통해 연산 가속·파운드리·메모리·네트워킹·서버 제조까지 투자 범위 확대. LLM 기반 테마 연관성과 시가총액을 반영해 관련 기업을 선별하고 분기별로 종목·비중을 조정하는 구조로, CPU 시장 성장성과 주변 AI 인프라 투자 확대에 동시 대응
참고자료	'ACE 미국CPU반도체TOP3+ ETF' 기초지수 구성종목 예시

구분	티커	종목명	비중	시가총액 (조원)	테마	기업 소개
1	ARM	ARM	24.15%	435	CPU	✓ 저전력·고효율 CPU 아키텍처의 글로벌 표준, 모바일을 넘어 데이터센터·AI 등으로 적용 분야 확대 ✓ AI·데이터센터용 CPU 수요 증가와 라이선스/로열티 기반 사업모델을 통한 중장기 성장 기대
2	AMD	AMD	24.13%	1,386	CPU	✓ 고성능 CPU 시장에서 경쟁력 강화, Ryzen·EPYC를 앞세워 PC·데이터센터 시장 점유율 확대 ✓ AI·데이터센터 투자 확대의 수혜, CPU와 GPU를 아우르는 컴퓨팅 포트폴리오로 성장 동력 확보
3	INTC	INTEL	23.59%	821	CPU	✓ x86 CPU 전통의 강자, PC·데이터센터 시장에서 탄탄한 고객 기반 보유 ✓ AI·데이터센터용 차세대 CPU 확대를 통한 실적 개선 기대
4	NVDA	NVIDIA	7.13%	7,750	CPU 밸류체인 (연산 가속)	✓ AI 가속기·GPU 시장의 선도 기업, AI 데이터센터 투자 확대의 핵심 수혜 기업 ✓ AI 데이터센터 확대 → CPU와 GPU 수요 동반 증가 → 엔비디아는 GPU뿐 아니라 Grace/Vera CPU까지 공급
5	TSM	TSMC	4.73%	2,821	CPU 밸류체인 (파운드리)	✓ 세계 최대 파운드리 기업*으로 AMD·NVIDIA 등 주요 반도체 기업의 고성능 CPU·GPU를 위탁 생산 (2026년 2분기 매출 및 점유율 기준 / 자료 : TrendForce / 기준일 : 2026.09.09) ✓ AI·데이터센터 확대 → 고성능 CPU·GPU 수요 증가 → TSMC의 첨단 반도체 생산 수요 확대
6	QCOM	QUALCOMM	4.46%	259	CPU 밸류체인 (연결)	✓ Snapdragon 기반 모바일·PC용 CPU 및 AI 프로세서를 개발하며, 5G 통신칩 분야에서도 높은 경쟁력을 보유 ✓ 온디바이스 AI 확산 → 고성능, 저전력 프로세서 수요 증가 → Snapdragon, Snapdragon 탑재 스마트폰·PC 확대
7	HPE	Hewlett Packard	3.40%	122	CPU 밸류체인 (서버)	✓ 서버·스토리지·네트워크 등 기업용 IT 인프라를 제공하는 글로벌 기업 ✓ AI·데이터센터 확대 → 고성능 CPU 서버 수요 증가 → AI·고성능 서버 수요 확대
8	MU	Micron	3.19%	1,612	CPU 밸류체인 (메모리)	✓ 미국 대표 메모리 반도체 기업으로 DRAM·HBM 등을 생산하며 CPU의 데이터 처리 성능을 뒷받침하는 솔루션 제공 ✓ AI·고성능 컴퓨팅 확산 → CPU·GPU의 데이터 처리량 증가 → DRAM·HBM 등 고성능 메모리 수요 확대
9	DELL	Dell Technologies	2.84%	472	CPU 밸류체인 (서버)	✓ Intel·AMD·NVIDIA 등 다양한 CPU 기반 서버 포트폴리오를 보유 ✓ AI·데이터센터 확대 → 고성능 CPU 서버 수요 증가 → Dell PowerEdge 서버 판매 확대 수혜
10	MRVL	Marvell	2.39%	320	CPU 밸류체인 (연결)	✓ 미국 데이터 인프라 반도체 기업으로 데이터센터용 커스텀 칩과 고속 네트워킹 반도체를 공급 ✓ AI·데이터센터 확대 → CPU·GPU 데이터 처리량 증가 → 고속 연결 및 맞춤형 칩 수요 증가의 수혜 기대

자료: 한국거래소, 한국투자신탁운용 주)2026-09-30 기준

ETF 명 (코드)	TIGER 글로벌MLCC&기판 (0255E0)
개요	- 한국, 일본 및 대만 상장기업 중 종합 전자부품기업, 전자소재 제조기업, PCB업체 등의 산업 분류에 속하는 기업에 투자하는 패시브 ETF
특징	- AI 하드웨어 병목인 MLCC와 FC-BGA 기판 시장을 대표하는 한국·일본·대만 13개 기업에 집중 투자
기초지수	- Solactive-KEDI Global MLCC and Semiconductor Substrate Index
종목 선정 기준	▶ 유니버스: Solactive GBS Global Markets All Cap USD Index PR의 구성 종목 中 - GBS 국가분류체계에 따라 일본, 한국, 대만 중 하나 - 시가총액 20억달러 이상, FactSet RBICS Subindustry 기준 다음 산업 중 하나(Diversified Electronic Components, Electronic Manufacturing, Other Passive Electronic Components, Other Interconnect Fabrication Services, Printed Circuit Board/Wiring Board Manufacturing, Other Passive Capacitor Electronic Components, Consumer Batteries Manufacturing, Printed Circuit Board, Diversified Technology Hardware) - FactSet 사업 설명에 다음 키워드 중 하나 이상의 키워드 포함(package, substrate(s), system-in-package, capacitor(s), flip chip substrate, circuit packaging, BGA ▶ 선정기준: 적격 종목은 모두 지수에 편입 - 적격 종목 10개 미만인 경우: 시가총액 기준을 USD 1억 단위로 단계적으로 낮춰가며 10개 종목이 확보될 때까지 완화 - 적격 종목 10개 초과하는 경우: 적격 종목 전체 편입 - 신규 IPO 종목: 유니버스 충족 + 상장 후 45일 이내, 시총 USD 5 Billion 이상 종목 편입 ▶ 비중결정방식: 유동시가총액 가중방식
출시 배경 및 투자포인트	▶ **AI 하드웨어 병목의 중심, MLCC와 기판:** AI 서버의 고성능화로 반도체뿐 아니라 전력을 안정적으로 공급하는 MLCC와 칩 간 고속 연결을 담당하는 기판의 중요성 확대. 2026~2028년 AI 하드웨어 밸류체인에서 FC-BGA·HBM·MLCC는 3년 연속 병목 단계에 들어설 전망. 엔비디아 차세대 VR200의 부품 원가는 GB300 대비 PCB 약 3.5배, MLCC 약 3.1배, FC-BGA 약 2.1배로, 칩이 커지고 고성능화될수록 부품 원가가 함께 커지는 구조. MLCC 탑재량도 스마트폰 1,000개, 일반 서버 2,200개에서 AI 서버는 28,000개로 늘어남 ▶ **가격과 출하량이 함께 오르는 P·Q 동시 상승:** AI 서버용 MLCC 수요는 '25~30년 연평균 약 30% 성장 전망이나, 고용량·고신뢰성 제품은 생산 기술과 증설 기간의 제약으로 공급 확대가 제한적인 상황. 주요 업체의 수주/출하(BB) 비율이 무라타 1.30배, 삼성전기 1.31배까지 상승했고, 삼성전기·야게오 등의 가격 인상 움직임도 본격화. 고부가 제품으로 생산능력이 집중되면서 범용 MLCC까지 수급 압박이 확산되는 가운데, FC-BGA 역시 대면적·고다층화에 따른 생산 난도와 수율 부담, 동박·CCL 등 소재 공급 제약으로 공급자 우위의 시장 환경 지속 전망 ▶ **한·일·대만 13개 기업, MLCC과 기판 양축 투자:** AI 서버용 MLCC 시장은 무라타와 삼성전기가 약 85%를 차지하는 과점 구조이며, FC-BGA 역시 일본 이비덴과 대만 유니마이크론 등 아시아 선도 기업 중심의 공급망 형성. 이에 맞춰 이에 무라타(약 19%)·유니마이크론(17%)·삼성전기(17%)를 핵심으로 TDK·이비덴·야게오·교세라 등 총 13개 기업에 투자. 일본 약 48%, 대만 33%, 한국 19% 비중으로 구성되며, 유동시가총액 가중방식과 종목당 20% 편입 한도를 적용해 MLCC·기판 산업의 성장 수혜를 동시에 추구
참고자료	'TIGER 글로벌MLCC&기판 ETF' 기초지수 구성 종목 예시

구분	기업명	구분	국가	비중
1	삼성전기	MLCC, 기판	한국	20.63%
2	MURATA	MLCC	일본	18.41%
3	UNIMICRON TECHNOLOGY	기판	대만	14.23%
4	TDK	MLCC	일본	12.27%
5	IBIDEN	기판	일본	9.91%
6	YAGEO	MLCC	대만	8.18%
7	KYOCERA	MLCC, 기판	일본	6.75%
8	KINSUS	기판	대만	3.08%
9	NAN YA PCB	기판	대만	2.47%
10	TAIYO YUDEN	MLCC	일본	1.86%
11	대덕전자	기판	한국	0.87%
12	WALSIN TECHNOLOGY	MLCC	대만	0.72%
13	SIMMTECH	기판	한국	0.62%



자료: 미래에셋자산운용 주)2026-08-31 기준. 구성종목 및 비중은 추후 변경될 수 있음

ETF 명 (코드)	1Q 엔비디아고정미국AI반도체 (0256C0)
개요	- 엔비디아를 비롯한 미국 AI 반도체 산업 핵심기업 10종목에 투자하는 패시브 ETF
특징	- 엔비디아를 약 25%로 고정 편입하고, 나머지 75%를 CPU·메모리·ASIC·네트워킹 등 AI 슈퍼사이클을 주도하는 미국 AI 반도체 대형주에 분산 투자
기초지수	- iSelect 엔비디아고정미국AI반도체
종목 선정 기준	▶ 유니버스: 엔비디아 + 미국 증권거래소(NYSE, NASDAQ 등) 상장된 종목 및 ADR 中 - 정량조건: 심사일(정기변경일 직전 달 마지막 영업일) 기준 20영업일 평균 시가총액 100억 달러 이상 및 20영업일 평균 거래대금 1억 달러 이상 - 완화된 정량조건: 심사일 기준 20영업일 평균 시가총액, 평균 거래대금 각각 10억 달러, 5,000만 달러 이상 ▶ 선정기준: AI 반도체 산업 관련 키워드 선정하여 종목별 키워드 점수 산출 - 기초 유니버스 내 엔비디아를 제외한 정량 조건 충족 종목을 스코어 상위 순으로 최대 9개 종목까지 선정(9 종목 미달 시 완화 조건 적용) ▶ 비중결정방식: 엔비디아 25% + 나머지 9종목 유동시총점수 및 Factor Score 곱한 비율 - 표준점수 〉0, Factor Score = 1+ 표준점수 표준점수 =〈 0, Factor Score = 1/(1-표준점수)
출시 배경 및 투자포인트	▶ **AI 경쟁이 키우는 반도체 수요:** 대규모 컴퓨팅 투자→AI 모델 성능 향상→서비스 확산→매출 증가→재투자로 이어지는 선순환 기대 속 빅테크와 프론티어 AI 기업의 인프라 투자 경쟁 지속. 맥킨지는 5대 하이퍼스케일러의 CapEx가 2026년 약 8,000억 달러에서 2027년 1조 달러로 확대될 것으로 전망. 챗봇에서 에이전트 AI로 진화하면서 추론 호출과 토큰 사용량이 늘어나는 가운데, 고성능 GPU뿐 아니라 CPU·HBM·네트워킹 등 데이터센터 반도체 전반으로 수요 확산 기대 ▶ **AI 반도체 시장의 리더, 미국:** 2025년 글로벌 반도체 매출 약 7,956억 달러 중 미국 기업이 53.4%를 차지하며, 설계·EDA·반도체 장비 등 고부가가치 영역에서 높은 경쟁력 유지. 매출의 약 20%를 R&D에 재투자하며 기술 우위를 강화하는 가운데, 미국은 전 세계 AI 데이터센터 5,427개를 보유하고 민간 AI 투자액도 2025년 2,859억 달러로 중국의 23배 수준. 핵심 AI 고객사와 반도체 설계 기업이 집적된 생태계에 더해, 2032년까지 미국 내 반도체 생산능력도 2022년 대비 203% 증가할 전망 ▶ **엔비디아 25% 고정 + 미국 AI 반도체 핵심 10종목:** GPU와 CUDA 생태계를 기반으로 'AI 팩토리' 기업으로 변모한 엔비디아는 10년 전 대비 매출이 40배 성장했고, 최근 미국 증시 역사상 최대 규모인 1,500억 달러 자사주 매입 한도 증액을 승인. 엔비디아를 약 25% 고정 편입하고 TSMC·브로드컴·AMD·마이크론·인텔·Arm·샌디스크·마벨·퀄컴 등 9종목을 추가해 GPU·CPU·메모리·ASIC까지 커버. 나머지 종목은 AI 관련도 기반 스코어링으로 선별하고 개별 비중을 최대 20%로 제한. 기존 반도체 ETF 대비 AI 인프라 관련도가 높은 10개 기업에 집중
참고자료	**'1Q 엔비디아고정미국AI반도체 ETF'** 기초지수 구성종목 예시

번호	종목명	비중	주요 사업부문
1	NVIDIA	26.42%	AI 가속기 중심의 데이터 센터 인프라와 PC용 지포스(GeForce) 그래픽 칩셋 및 자율주행 차량용 플랫폼 사업
2	TSMC	20.59%	세계 최대 규모의 반도체 위탁 생산(파운드리) 서비스
3	Broadcom	19.05%	통신 및 데이터 센터용 반도체, 네트워킹 소프트웨어 및 인프라 솔루션
4	AMD	10.75%	CPU(Ryzen, EPYC), GPU, 데이터 센터 및 임베디드 프로세서 설계
5	Micron Technology	10.61%	메모리 및 스토리지 솔루션(DRAM, NAND 플래시 등) 제조
6	Intel	5.35%	PC 및 데이터 센터용 프로세서 개발, 파운드리 서비스(IFS)
7	Arm Holdings	2.49%	모바일 및 고성능 컴퓨팅을 위한 저전력 프로세서 아키텍처 IP 설계
8	Sandisk	1.63%	플래시 메모리 기반의 저장 장치(SSD, 메모리 카드 등) 솔루션
9	Marvell Technology	1.60%	데이터 인프라를 위한 고성능 데이터 처리 및 네트워킹 칩셋 솔루션
10	QUALCOMM	1.51%	무선 통신 기술, 스마트폰용 모바일 프로세서(Snapdragon) 및 모뎀 설계

자료: iSelect, 하나자산운용 주) 2026-07-31 기준. 구성종목 및 비중은 향후 변경될 수 있음

국내 신규출시 ETF 리스트 (최근 1개월)

상장일	티커	ETF 명	AuM (억원)	개요
09/22	0238C0	**IBK 한미대표기업 TOP2+채권혼합 50 액티브**	213	한국·미국의 시가총액 1 위 기업과 통안채를 5:5 비중으로 투자하되 일부 종목을 추가 편입하여 초과수익을 추구하는 액티브 ETF
09/22	0240J0	**RISE 삼성 SK 그룹**	205	삼성·SK 그룹의 상장회사를 유니버스로 하여 유동시가총액 상위 10 종목에 투자하는 패시브 ETF
09/22	0241R0	**TIGER 현대차 LG 전자고정피지컬 AI 밸류체인**	172	현대차, LG 전자 (각 25%) 및 국내외 피지컬 AI 관련 기업에 투자하는 패시브 ETF
09/22	0242S0	**파워 SK 그룹**	136	SK 그룹의 상장회사에 투자하는 패시브 ETF
10/07	0246X0	**SOL 글로벌 DRAM 반도체플러스**	791	한국, 미국, 일본 거래소에 상장된 메모리 반도체 관련 기업에 집중 투자하는 패시브 ETF
10/13	0254W0	**ACE 29-11 회사채(AA-이상)액티브**	200	'29 년 10~12 월에 만기 도래하는 AA-이상 등급 특수채, 은행채, 회사채 등에 투자하는 만기매칭형(존속기한형) 액티브 ETF
10/13	0243M0	**DS AI 반도체액티브**	79	국내 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 액티브 ETF
10/13	0247S0	**KIWOOM 글로벌 MLCC&AI 기판 TOP4+**	78	한국, 미국, 일본 상장기업 중 MLCC 및 기판 관련 10 개 기업에 투자하는 패시브 ETF
10/13	0241D0	**KODEX 미국 AI 에이전트액티브**	463	미국의 AI 에이전트 관련 기업에 투자하는 액티브 ETF

자료: KRX, 키움증권 리서치, 주) 2026.10.16 기준

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지사항

- 본 조사분석자료는 당사의 리서치센터가 신뢰할 수 있는 자료 및 정보로부터 얻은 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없고, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다.
- 본 조사분석자료는 유가증권 투자를 위한 정보제공을 목적으로 당사 고객에게 배포되는 참고자료로서, 유가증권의 종류, 종목, 매매의 구분과 방법 등에 관한 의사결정은 전적으로 투자자 자신의 판단과 책임하에 이루어져야 하며, 당사는 본 자료의 내용에 의거하여 행해진 일체의 투자행위 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 않으며 법적 분쟁에서 증거로 사용 될 수 없습니다.
- 본 조사 분석자료를 무단으로 인용, 복제, 전시, 배포, 전송, 편집, 번역, 출판하는 등의 방법으로 저작권을 침해하는 경우에는 관련법에 의하여 민·형사상 책임을 지게 됩니다.